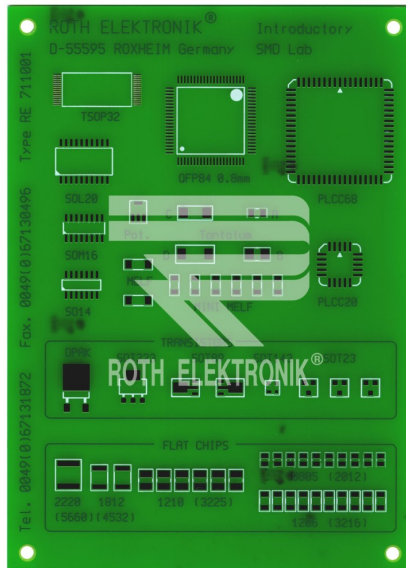


**Placa de circuito impreso para la introducción en el montaje de superficie SMD**



**RE711001-LF**



- epóxido FR4, 1,50 mm, por un lado 35 µm CU
- Lado de soldadura estañado en caliente (HAL-leadfree), máscara de inhibición de soldadura e impresión de dotación
- placa de circuito impreso para la introducción en el montaje de superficie SMD
- adecuada también para la dotación automática (pick and place)
- tamaño: 100 x 140 mm
- 57 componentes SMD distintos:

PLCC:	20, 68	Tantal	Chip	condens.	A: 1
QFP:	84 sq.	"	"	"	B: 1
TSOP 32:	1 x	"	"	"	C: 1
SO 14:	1 x	"	"	"	D: 1
SOM16:	1 x	1206	Chip condens.		: 10
SOL 20:	1 x	0805	"	"	: 10
SOT 23:	3 x	1210	"	"	: 6
SOT 143:	1 x	1812	"	"	: 2
SOT 89:	2 x	2220	"	"	: 1
SOT 233:	1 x				
DPAK:	1 x	2308	Melf		: 2
Poti:	1 x	1206	Mini Melf		: 6